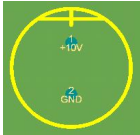


| | | | | | |
|---------------|------|-----------------|----|-----|-----------|
| PCB | 产品名称 | 产品型号 | 版本 | 页数 | 制订时间 |
| 焊接工艺要求 | 交流伺服 | ISED-F04F1 焊接要求 | V8 | 1/1 | 2024-6-11 |

1. 参照“ISED-F04F1-V8 序号 PDF”文件；
2. C98、C133、C107、C173 四个电解电容要平躺焊接，焊接前先成型，注意极性，电容与线路板接触的面要点胶（黑色 704 胶），紧贴线路板焊接；
3. 有焊接高度要求的元件；
 - D5（整理桥）焊接前要成型，注意极性，安装孔要正对线路板的孔，D5 的平面与线路板平行，与线路板远的一面距离线路板为 7mm ；
 - Q2（LKB40N65TM1）焊接前要成型，有字的一面靠近线路板，其金属面与线路板平行，金属面距离线路板为 7mm，安装孔要正对线路板的孔；
4. 焊接 U1 时要保证 U1 的上平面 平行于线路板，U1 的管脚本身有自然的卡点，卡点紧贴线路板；
5. 打叉的元件 不焊接；红色方框内的元件不焊接；
6.  图形中的“+”号，表示是电容的正极，焊接时要注意；
7. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；
8. 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；
9. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 编制 | | 审核 | | 批准 | |
| 日期 | | 日期 | | 日期 | |